

Revista Electrónica de Ingeniería y Aplicación (REIA), Año 4, No 4, Septiembre 2017 – Septiembre 2018, es una publicación anual editada por el Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, a través de las divisiones de Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Energías Renovables e Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable, Domicilio Conocido S/N, El Saucillo, Huichapan, Hidalgo, CP 42411, Tel. 7617248080, www.iteshu.edu.mx. iteshu@iteshu.edu.mx , editor responsable: Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2017-121114220600-203, ISSN 2448-6817, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Responsable de la última actualización de este número, Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, Domicilio Conocido S/N, El Saucillo, Huichapan, Hidalgo, CP. 42411, Municipio de Huichapan, estado de Hidalgo. Fecha de última modificación: 29 de Septiembre de 2018.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.

Queda estrictamente la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan.